

2007年3月期 事業説明会（2006年8月4日実施）

スライドP 1～ 代表取締役社長 川村 誠スピーチ

スライドP 20～ 執行役員常務 ファインセラミック事業本部長 兼 半導体部品事業本部長
久芳 徹夫スピーチ

スライドP 28～ 京セラミタ㈱代表取締役会長 兼 社長 関 浩二スピーチ

代表取締役社長 川村 誠スピーチ

<スライド1：将来予想に関する注意事項>

本日、当社からご説明いたします内容につきましては、スライド1ページにあります「将来予想に関する注意事項」にご留意願います。

<スライド2：2007年3月期第1四半期 連結決算実績>

連結売上高は、前年同期比10.4%増収の2,926億円、営業利益は114.5%の増益、つまり2.1倍となる306億円、税引前四半期純利益は同じく2.1倍の369億円、四半期純利益は2.3倍の200億円となりました。当期第1四半期の設備投資額、減価償却費、研究開発費を記載しております。当期第1四半期の設備投資額は167億円となり、前年同期の270億円に対して38.1%の減少となりました。

当期第1四半期は、旺盛な部品需要に対応するため、セラミックパッケージなどの増産投資を行いました。しかし、有機パッケージやソーラーエネルギー事業において、新工場の建設などを行った前期第1四半期と比較しますと、減少しました。

一方、当期第1四半期の減価償却費は、前期の設備投資の増加を受け、前年同期の131億円に比較し、9.8%増加の144億円となりました。研究開発費につきましては、前年同期の144億円に比較し、8.1%増加の156億円となりました。

前年同期に比べ、減価償却費と研究開発費は増加しましたが、増収効果と内部改善を背景に、当期第1四半期は大幅な増益を達成しました。

また米ドルとユーロの平均為替レートは、当期第1四半期は、1ドルが115円、

1ユーロが144円となり、為替の変動による影響額は、その右にありますように、前年同期に比べ、売上高は109億円、税引前四半期純利益は36億円のプラス要因となりました。

<スライド3：2007年3月期 第1四半期の成果>

当期第1四半期の業績は、「アメーバ経営への原点回帰」の方針が徐々に浸透してきた表れであると、手応えを感じています。大部分の事業セグメントにおいて社内計画を上回る実績をあげることができました。また、部品事業のすべての事業セグメントが、「価値ある事業」の基準としている最低15%以上の事業利益率を達成いたしました。

さらに、前年同期と比較しますと、連結売上高は10%を超える増収となり、営業利益は2.1倍に拡大しました。特に、「電子デバイス関連事業」において、AVXの収益拡大や、コンデンサ事業において、小型大容量セラミックコンデンサなどの新製品の売上増に加え、中国工場での生産拡大に伴い、製造コストを削減することができました。また、「半導体部品関連事業」では、デジタルコンシューマ機器向けの電子部品用表面実装(SMD)パッケージやCCD/CMOS用パッケージの売上増に加え、国内及び中国工場で原価低減活動の成果が表れてきました。

「通信機器関連事業」においては、KWCの損失が縮小したことに加え、国内市場向けの携帯電話端末やPHS端末の新製品効果により収益性が向上し、「通信機器関連事業」全体で事業損失を縮小することができました。

<スライド4：2007年3月期第1四半期 事業セグメント別売上高・税引前四半期純利益>

こちらのスライドは、各事業セグメントの売上高と税引前四半期純利益が、前年同期に比べどれだけ増減したかを示したグラフであり、上段が売上高、下段が税引前四半期純利益の増減額であります。

先ほど申しあげました3つの事業を中心に、部品及び機器の両事業において増収増益を達成しております。部品事業は、前年同期に比較し、売上高で208億円、税引前四半期純利益で110億円の増加となりました。また、機器事業においては、売上高で56億円、税引前四半期純利益で59億円の増加となりました。

<スライド5：新製品開発・新事業創造の取り組み>

当期第1四半期の実績は、ただ今申し上げたとおりであります。今後の事業拡大のための新製品開発・新事業創造の取り組みも、継続的に行いました。

まず、コンデンサでは、AVXより、ネットワーク通信機器並びにサーバー向けのDC-DCコンバーターやデカップリングコンデンサ用に、製品構造を見直し、これまで以上の低ESR（等価直列抵抗）を実現した「酸化ニオブコンデンサ」を5月に発売いたしました。

また、X7R（エックス・セブン・アール）の温度特性に加え、高い誘電率により実装面積を従来の3分の2とし、電子回路の小型化に適したセラミックコンデンサを7月初旬に市場投入いたしました。今後とも、幅広い市場ニーズを捉えるべく、製品ラインアップを強化し、一層の売上拡大を図ってまいります。

携帯電話端末では、国内市場でシェアアップを図るため、WIN端末の「W42K」とCDMA1X端末の「A5521K」を6月初旬より発売しました。おかげさまで両機種とも販売は好調に推移しており、今期通期の目標であるauでのトップシェアの獲得に貢献するものと考えております。

さらに、開発を継続している固体酸化物形燃料電池の実用化に向けた研究開発も進めております。

当期第1四半期においては、大阪ガスと共同で昨年から進めてまいりました、国内では初めてとなります、実際のご家庭での運用試験において、発電効率などで、開発目標を上回る結果を得ることができました。今後も開発を強化し、1日も早い実用化に向けて取り組んでまいります。

<スライド6：2007年3月期 連結業績予想>

2007年3月期の連結業績予想をこちらに示しております。今回、平均為替レートの見直しにつきましては、第1四半期の実勢レートをもとに変更いたしましたが、通期業績予想については変更しておりません。

第1四半期は、社内計画を上回る実績を残すことができました。しかし、下半期以降の市場見通しは、米国経済や、原油・素材高の影響など、未だ不透明な要因もあり、もうしばらく先行きを見極める必要があると考えております。

第2四半期以降の部品需要は、高水準で推移するものと予想しており、恵まれた

市場環境のもと、旺盛な部品需要を確実に捉えるとともに、引き続き新製品をタイムリーに投入することで、一層の売上及び利益の拡大を図り、この通期業績予想を確実に達成してまいります。

<スライド7：京セラグループの経営基本方針>

こちらのスライドは、京セラグループの3つの経営基本方針を示しております。この経営基本方針については、皆様にはすでにご説明しておりますが、私は、「さらに成長し続ける創造型企業の実現」に向けて、ここに示しました「高収益体質の構築」、「お客様第一主義を貫く」、「さらなるグローバル経営の推進」の3点を経営基本方針としております。

<スライド8：「高収益体質の構築」のための取り組み>

本日は、3つの経営基本方針のうち、「高収益体質の構築」の取り組みについて、ご説明させていただきます。

具体的な取り組みは、このスライドに示しておりますとおり4点あります。

第1に「アメーバ経営の実践による現場力・実現力の強化」、第2に「資産効率の向上」、第3に「事業領域の選択」、第4に「売上拡大と最低15%以上の連結税引前利益率の達成」であります。この4つの取り組みを行うことで、「高収益体質」を構築し、「さらに成長し続ける創造型企業」を実現してまいります。

それでは、4つの具体的な取り組み内容について順次ご説明いたします。

第1に、「アメーバ経営管理システム」を企業成長の基盤として、現場力と実現力を強化してまいります。当期第1四半期の実績は社内計画を上回る結果でありました。第2四半期以降においても、「アメーバ経営への原点回帰」の方針を一層社内に浸透させ、現場力と実現力の強化を進めてまいります。

2つ目に、「資産効率の向上」を図ってまいります。

<スライド9：企業価値増大に向けた資産効率の向上>

京セラグループは、収益性を向上させるだけでなく、経営資源を有効に活用する

ために、グループの経営資産効率を向上させ、「収益性」と「資産効率」の両面から、さらなる企業価値向上を目指してまいります。

具体的には、資産効率の向上を目指し、売掛債権の早期回収や、棚卸資産の適正化、設備投資を含む固定資産の効率化に努めてまいります。この資産効率の向上とアメーバ経営管理システムに基づいた「時間当たり採算」による収益の向上により、企業価値の増大を図ってまいります。

<スライド10：「高収益体質の構築」のための取り組み>

また、京セラグループは、今後も「高いマーケットシェアを持つ市場及び成長が見込まれる市場」に集中してまいります。

当社は、やみくもに事業を拡大するのではなく、優位性が発揮でき、かつ事業の成長が見込まれる事業領域に経営資源を投入し、事業を行ってまいります。

このような考えに基づき、今期に入り決定した「選択と集中」の具体例として、強化した事業と見直しを行なった事業についてご説明いたします。

<スライド11：強化事業 水晶デバイス事業>

まず、強化した事業の例として、7月19日に決定しましたヘルツ社の子会社化についてご説明いたします。

ヘルツ社の子会社化の目的は大きく2つあります。ひとつは、高い音叉型水晶振動子技術の獲得であります。これにより、京セラグループは、水晶デバイスのすべての製品をカバーするメーカーとなり、幅広い事業展開が可能となります。

2つ目に、携帯電話端末や携帯音楽プレーヤーなどの電子機器向けに、需要拡大が見込まれる音叉型水晶振動子市場において、強固な事業基盤を確立することにあります。

電子機器向けの音叉型水晶振動子の生産は、年率5%の成長が見込まれております。この成長市場において事業拡大を図り、一層の売上拡大につなげてまいります。

<スライド12：見直し事業 京セラリーシング(株)>

次に、見直しを行った事業の例として、7月27日に決定いたしました京セラリ

ーシング（株）の株式譲渡契約についてご説明いたします。

京セラリーシングは、これまでグループの資金運用、財務内容の健全化をサポートする金融会社として事業を行ってきました。しかし、金融業界の再編が進むなかで、同社の競争力向上のための事業強化の必要性が高まる一方で、セラミック部品や電子部品、電子機器などの製造・販売を事業の中心とするグループの事業展開からは、大きく業態が異なっておりました。

このような状況において、私は、京セラグループの経営基本方針のひとつである「高いマーケットシェアを持つ市場及び成長が見込まれる市場を事業領域とする」という考えに基づき、同社株式をダイヤモンドリース社へ譲渡することを決定いたしました。

京セラグループは、今後とも、強化すべき事業へ経営資源を集中し、グループの企業価値の増大を図ってまいります。

<スライド13：「高収益体質の構築」のための取り組み>

「高収益体質の構築」のための取り組みの4つ目は、「持続的な売上拡大」と「高い連結税引前利益率」の達成を目指すことであります。

私が社長に就任し、1年以上が経過しましたが、この間、私は各事業の現状と将来性について把握し、それぞれの強みを認識いたしました。本日は、この強みを活かした各事業の戦略についてご説明いたします。

なお、「ファインセラミック部品事業」と「情報機器関連事業」については、後ほどそれぞれの事業本部長よりご説明いたしますので、この2つの事業については、私の説明は割愛させていただきます。

<スライド14：事業セグメント別の事業戦略（1）>

まず、「半導体部品関連事業」であります。セラミックパッケージ事業の強みは、電子部品用表面実装（SMD）パッケージやCCD/CMOS用パッケージにおいて、トップシェアであるということです。セラミックスは、高い剛性と熱伝導性に優れた材料特性があり、この特徴を活かした当社のセラミックパッケージは、携帯電話端末やデジタル家電などの多くの電子機器の中で使用されております。また、当社には、高い生産・設計・評価・加工技術があります。これらの強みを

活かした取り組みを3つご紹介いたします。

まず、長年蓄積してきたセラミックパッケージの高い技術力を活かし、携帯電話端末に搭載される部品の製品ラインアップの拡充を図ってまいります。BluetoothやTVチューナーなどのアクセサリモジュール向けのLTCC基板や、カメラモジュール向けのアルミナセラミックパッケージを展開してまいります。次に、デジタル家電市場だけでなく、車載、医療市場などへの用途拡大を進めてまいります。

3つ目に、中国工場での増産を進めてまいります。

有機パッケージ事業の強みは、設計から実装に至るまでのプロセスを考慮した業界最高水準の高密度配線技術を有していることでもあります。

次世代ゲーム機関連市場の展開では、本年より京都・綾部市の新工場を中心に、最先端フリップチップパッケージの生産数量を大幅に拡大していく計画であります。

当社は、ゲーム機関連用パッケージ事業を主体に、フリップチップパッケージでのシェアを大きく伸ばしてまいります。

<スライド15：事業セグメント別の事業戦略（2）>

続いて「ファインセラミック応用品関連事業」の代表例として、ソーラーエネルギー事業の取り組みをご紹介いたします。

ソーラー発電システムは、世界中で普及が加速しております。

私は、この事業において、当社の強みである世界4極でのグローバル生産体制と、業界最大級の一貫生産ラインを活かし、今後さらに市場拡大が見込まれる大規模系統連携市場と独立電源市場の2大市場へ積極的に販売活動を行ってまいります。ソーラーエネルギー市場は、2010年まで年率23%の伸びが見込まれます。昨年、2005年暦年の京セラグループの生産量は世界3位の140MWでありました。2010年までには、この需要増大を確実に事業拡大に結びつけ、3.5倍となる生産量500MWの達成と、さらなるシェア向上を目指してまいります。現在、太陽電池の需要は、シリコンメーカーの生産を上回る勢いで拡大しており、シリコンメーカー各社が生産能力の増強に取り組んでいるものの、シリコン原料が一時的に供給不足に陥っております。そのため、当社の今期通期業

績は、これまでの急成長から踊り場になることを予想しております。しかし、変換効率の向上や、セルの薄型化、歩留まりの改善により、シリコン原料の使用効率向上に努め、2008年3月期に再び成長軌道に乗せるための十分な準備を行ってまいります。

<スライド16：事業セグメント別の事業戦略（3）- 1 >

続いて、「電子デバイス関連事業」です。この事業では、強みであるグループシナジーを最大限に活かし、部品から機器まで行うグループの連携により、市場ニーズを先取りした部品開発を進めてまいります。

このスライドに示しておりますとおり、京セラグループには、京セラの電子部品に加え、主にセラミックやタンタルコンデンサ事業を行うAVX、水晶デバイス事業の京セラキンセキ、コネクタ事業の京セラエルコなどの子会社があります。また、これらの一般電子部品に、薄膜デバイスを加えた電子デバイス関連事業のほか、ファインセラミック部品関連事業や半導体部品関連事業などの部品事業、及び通信機器関連事業などの機器事業を展開しており、また、通信キャリアのKDDI社やWILLCOM社との密接な関係を有しております。

このような事業間、企業間のグループシナジーを活かした総合力こそが、競合の電子部品専門メーカーにない強みであると考えております。

<スライド17：事業セグメント別の事業戦略（3）- 2 >

携帯電話端末やPHS端末向けのビジネスを例に、当社のグループシナジーをご紹介いたします。当社は、このスライドに示しているような各種電子デバイスを携帯電話端末に搭載し、完成品としてKDDI社に納めております。

例えば、セラミックコンデンサでは、京セラのコンデンサ事業とAVXが材料や製造工法における技術交流を行い、製造技術や生産技術の向上を図っております。また、同事業と京セラケミカル(株)がペーストなどの共同開発を行っております。ブルートゥースモジュールでは、京セラのセラミックコンデンサや京セラキンセキの水晶振動子、半導体部品関連事業のLTCC基板が使われております。このようにグループ間の連携により、高品質な電子デバイスを製造し、それを活かして京セラの携帯電話端末などを製造しております。

グループの総合力により、ひとつの製品に対し多くの部品を供給できる強みを活かし、電子デバイス関連事業のさらなる事業拡大を図ってまいります。

<スライド18：事業セグメント別の事業戦略（4）>

続きまして、「通信機器関連事業」についてご説明いたします。移動体通信機器事業における強みは、KDDI社との密接な関係と、京セラグループの部品事業とのシナジーであります。KDDI社や部品事業との連携により、市場ニーズを的確に捉えた新製品の開発、製造、販売を進めてまいります。

通信システム機器事業では、当社が30%を出資するWILLCOM社と戦略を共有し、国内市場向けのPHS基地局ビジネスの拡大と、PHS端末のさらなるシェアアップを図ってまいります。また、iBurst™の導入国拡大に取り組んでまいります。

<スライド19：京セラグループの事業ポートフォリオ>

ただ今申し上げましたとおり、それぞれの事業で強みを活かした事業展開を行うことで、各事業の一層の収益拡大に取り組んでまいります。

こちらのスライドは、京セラグループの事業ポートフォリオを、2007年3月期通期の連結売上高成長率と事業利益率の予想を基準に示しております。

横軸は、2006年3月期において連結売上高1兆円を越える主要電子機器メーカー9社の今期の売上高成長率の平均である4%を基準としています。縦軸は、事業利益率を示しており、目標である15%以上の事業利益率の達成に至る重要な節目となる10%を基準に区切っております。

なお、それぞれのエリアで示している数値は、そのエリアに属する事業の売上高構成比であります。また、4つのエリアの売上高構成比の合計は、連結消去を考慮しておりませんので、100%とはならないことをご了承願います。

それでは、構造改革の途上にある光学機器関連事業を除いたそれぞれのエリアについてご説明いたします。

当社の売上高構成比で最も高いエリアは、右上のピンクで示した部分であり、全体の44%を占めます。ここには、「半導体部品関連事業」、「情報機器関連事業」、「その他の事業」が含まれます。

これらの事業は、今期、売上高成長率は主要電子機器メーカーの平均を上回る見通しであります。また、事業利益率は、10%を超える見通しであり、15%の事業利益率も視野に入るレベルとなっております。

その下の黄色で示したエリアには、「通信機器関連事業」があり、売上高構成比は20%を占めております。「通信機器関連事業」は、今期、売上高成長率は主要電子機器メーカーの平均を上回るものの、事業利益率は10%を下回る見通しであります。従って、「通信機器関連事業」の課題は、事業利益率を向上させることであります。

緑色のエリアは、売上高構成比37%を占めており、ここには「ファインセラミック部品関連事業」と「ファインセラミック応用品関連事業」、「電子デバイス関連事業」が含まれます。このエリアにある事業は、今期、すべて10%以上の事業利益率を達成する見通しであり、なかには15%を超える事業利益率の達成が期待できる事業もあります。しかし、売上高成長率は、主要電子機器メーカーの平均を下回る見通しであり、このエリアにある事業の課題は、売上高の拡大であります。

私は、すべての事業を早急にピンクのエリアに入るよう強化してまいります。また、すでにこのエリアにある事業は、さらなる売上高成長率と事業利益率の向上に努めてまいります。

それでは、本日はこの事業ポートフォリオのなかで、既に高収益を達成し、今後、売上を拡大させることで一層の事業利益率向上が期待できる「ファインセラミック部品事業」と、事業拡大を図ることで、確固たる「価値ある事業」となり、京セラグループの成長に大きく貢献すると見込まれる「情報機器関連事業」について、久芳と関よりそれぞれご説明させていただきます。

iBurst™ は ArrayComm, Inc. の登録商標です。

執行役員常務 ファインセラミック事業本部 兼 半導体部品事業本部長

久芳 徹夫スピーチ

<スライド20：ファインセラミック部品事業の事業戦略>

ファインセラミック部品事業の事業戦略は、重点市場の強化と、新市場開拓の2点です。

<スライド21：(1)重点市場の強化 半導体・液晶製造装置市場>

一つ目の、重点市場の強化について説明いたします。

このグラフは、ファインセラミック事業本部の、市場別受注構成を示したものです。

半導体・液晶製造装置業界は、構成品種が少ないながら、3分の1以上を占める大変重要な市場です。

単結晶サファイア事業は、LED用基板、プロジェクター用部品で、構成されています。

情報通信関連業界向けは、ハードディスク関連部品、プリンタ部品、携帯電話用アンテナ、電子回路基板、などの多品種で構成されています。

一般産業機械向けは、ポンプバルブ、湯水混合栓、繊維機械、自動車関連など、多くの業界で構成されます。

半導体・液晶製造装置市場は、売上規模が大きく、業界トップシェアである為、事業拡大における重点市場として、強化してまいります。

<スライド22：(1)重点市場の強化 半導体・液晶製造装置市場>

左のグラフは、半導体製造装置市場を示します。青の折れ線は、半導体チップの売上の成長率を示し、赤の折れ線は、製造装置の売上の成長率を示しています。シリコンサイクルの影響で、年度によっては減少する事がありますが、パソコン、携帯電話の性能向上と、デジタル家電の拡大に合わせ、今後も拡大が見込まれています。

右のグラフは、液晶製造装置市場を示します。青の折れ線は、大型液晶パネルの生産枚数の成長率を示し、赤の折れ線は、製造装置の売上の成長率を示しています。大型平面TVの需要増加に伴い、こちらも、成長が期待されている市場です。

<スライド23:(1)重点市場の強化 半導体・液晶製造装置市場>

半導体製造装置の技術トレンドと、市場のニーズについて説明します。

一つ目は、配線の微細化に伴う、低パーティクル化です。このグラフは、半導体配線ルールのトレンドを示しています。現在主力の80ナノメートルから、2010年には、45ナノまで、微細化が進むと予想されています。この為、パーティクルの発生を嫌う製造装置部材には、プラズマ処理に対してパーティクルの発生が極小となる、耐プラズマ材料が求められます。この図は、部材が、プラズマ処理で削られる量を、材料別に、比率で示したものです。これまで、部材として多く使われていたクォーツに対し、現在主流の、高純度アルミナセラミックスは、10分の1以下です。つまり、パーティクルの削減には、ファインセラミックスが優位である事がわかります。当社では、さらに、約3分の1少ない、イットリア材料も開発いたしました。

二つ目は、高生産性を目指した、軽量・高剛性部材のニーズです。これに対しても、セラミックスの、軽量・高剛性の特長を生かせます。当社では、SiC材料の展開と、セラミックスの接合による、中空構造部材の開発を行っております。この様に、市場の要求に対して、さきんじた開発を行う事により、差別化を図っております。

<スライド24:(1)重点市場の強化 半導体・液晶製造装置市場>

液晶製造装置の技術トレンドは、大型化です。

液晶製造装置に使用されるセラミック部品は、マザーガラスを保持する為、ガラスより大きなサイズになります。このサイズのトレンドを図に示しました。

製造装置メーカーでは、第7世代装置の量産が本格化し、我々は、2.1m かけ 2.4m の大型品の納入を行っております。また、第8世代の試作も始まり、将来的には、第9世代へとさらに大型化が予想される為、セラミック部品のさらなる大型化対応が重要です。製品が大きくなるに従い、成形、焼成の難易度は、飛躍的に高まりますが、自社で保有するスーパーコンピューターによるシミュレーション技術を活用し、焼成時の温度分布や、収縮時の応力解析、製品の剛性や、固有振動数を最適化する事が可能です。

また、市場の拡大と大型化のトレンドを見越し、昨年、いち早く滋賀県八日市市に、研削、組立などの後工程の新工場を新設いたしました。

大型製品に適した社内一貫生産ラインにより、高い生産性で、競合他社との差別化をはかって参ります。

この様に、市場のトレンドを先取りし、また、お客様のニーズに応じて行くことで、今後も、高い成長性の半導体・液晶製造装置業界で、売上拡大を図っていく計画です。

<スライド25:(2)新市場開拓>

次に、新市場開拓について説明します。

このグラフの赤い折れ線は、ファインセラミック事業本部の事業規模を示しています。

1960年3月期は、当社が創業した年であり、ブラウン管用絶縁部品のU字ケルシマというファインセラミック部品からスタートしました。

その後、ファインセラミックス材料の特性を進化させ、80年代までは、繊維機械用部品、製紙部品、ポンプ部品などの耐摩耗部品を皮切りに、ドットプリンター用ワイヤーガイド、金属溶湯用保護管など、多くの産業分野へと用途を広げて参りました。

さらに、90年代からは、半導体、液晶の製造装置部品や、携帯電話の基地局用誘電体、LED用基板など、用途を拡大し、事業規模を大きく伸ばして参りました。

この創業以来続く、市場開拓の歴史が、ファインセラミックの歴史であり、当社の原点です。現在も、あらゆる産業にセラミックスを普及させる事を目標に、売上拡大に注力しております。

<スライド26:(2)新市場開拓>

事業規模を伸ばし、高収益事業として来られたのは、ここに挙げますファインセラミックのコア技術を進化させてきた為です。

材料技術を進化させると同時に、成形や焼成、加工などのプロセス技術も進化させて来ました。材料やプロセス技術の進化の為に、設計技術や計測評価技術の進化も、はかって参りました。

今後も、セラミックス事業で、売上拡大を行い、より高収益としていく為、アメリカ経営の実践による現場力の向上に加え、材料開発、プロセス開発を、継続的にすすめていく計画です。

<スライド27:(2)新市場開拓>

これらが、現在、開拓をすすめている新市場です。

装飾用カラーセラミックは、セラミックスの耐摩耗性による傷が付きにくい特長と、金属では得られない質感のある色調を生かし、宝飾品、時計部品、高級携帯電話へと用途の拡大を図っています。

今後、市場拡大が見込まれる医療・分析機器市場の開拓にも注力しております。一例を紹介しますと、医療機器向けに、セラミックスの高い絶縁性を生かしたCT スキャン用電極部品や、セラミックスの化学的安定性を生かした分析機器部品などで、セラミックス材料の特長を生かし用途展開をすすめています。

また、社長の川村より紹介させていただきました固体酸化形燃料電池 SOFC は、総合研究所が中心に開発を進めています。

この SOFC に用いられるセラミックセルの材料開発や、プロセス開発に関しては、我々の事業本部のコア技術が、活用されており、協力して進めています。

これら新市場の開拓と、冒頭に述べました重点市場の強化に注力し、今後も、売上を伸ばしていく計画です。

京セラミタ株代表取締役会長 兼 社長 関 浩二スピーチ

<スライド28：第1四半期の実績は前年同期比で増収増益>

当期第1四半期は、私が社長に就任し、新しい経営体制となってから、最初の報告となります。連結売上高は、60,266百万円となり、前年同期比4.1%増加いたしました。税引前利益は8,651百万円、前年同期比12.9%の増加となり、税引前利益率は14.4%となりました。

当期の売上拡大の牽引役として期待される、カラー複合機3機種は5月から出荷が始まりましたが、国内市場向けには6月末から販売を開始したため、残念ながら

ら第1四半期の売上にはほとんど貢献しておりません。このスライドに示しました第1四半期の実績は、主に旧製品が中心であったため、販売価格は下がり、売上では苦しい状況でありました。しかし、為替が円安で推移したことや、全社経費の削減効果により前年同期に比べ、増収増益で終了することが出来ました。

<スライド29：情報機器関連事業 売上高・税引前利益率の推移>

このスライドの表は、過去の情報機器関連事業の売上高と税引前利益の推移を示しております。青色の棒グラフが売上高で、赤色の折れ線グラフは税引前利益率を示しております。

1998年に三田工業が倒産し、その後京セラのプリンタ事業と統合して以来、必死にがんばってきた結果、ここに示しましたとおり、売上高について2006年3月期まで右肩上がりで拡大しました。税引前利益率については、残念ながら2006年3月期は2005年3月期に比べ悪化しましたが、当期第1四半期には、14.4%まで回復いたしました。

第2四半期は、例年、海外の夏休みなどの季節要因により、業績は低下傾向となりますが、今期通期の業績予想である売上高2,600億円、税引前利益率11%は必ず達成したいと考えております。特に今期は、カラー製品の貢献が見込まれます。カラー製品の場合は、本体だけでなく、消耗品の貢献も期待しております。

<スライド30：2006年に23機種の新モデル投入を計画>

2006年は、カラーを含めた新モデルを23機種投入する予定であります。カラーモデルでは、複合機を3モデル、プリンタを5モデル投入いたします。それ以外は、モノクロモデルで複合機、プリンタを投入いたします。すでにほぼ半数の新製品を生産、もしくは出荷ははじめており、残りは順次投入してまいります。現在、部品価格が高騰する一方で、製品価格は下がるという、大変厳しい市場状況ではありますが、旧製品から新モデルに置き換えることによって、十分売上増を達成できると考えております。

<スライド31：京セラミタ独自の戦略“エコシス”コンセプト>

倒産した三田工業と京セラの一事業であるプリンタ事業が一緒になった当初、我々には、大手メーカーに勝てる要素はどこにもありませんでした。しかし我々は、他社が敷いた消耗品ビジネスを重視した路線ではなく、長寿命化技術を複写機にもプリンタにも取り入れた独自のエコシス路線を進めてまいりました。その結果、長寿命化技術を確立し、お客様やディーラー様の信頼性を高めることができました。これが他社との差別化となって現れ、今日の業績をあげられるようになっております。我々の今があるのは、他社とはまったく異なる、どこもやらないことをやってきた成果であります。我々は、今後とも、カラー製品においても、長寿命化を実現することで、必ずや事業を拡大させてまいります。

<スライド32：進化する“エコシス”コンセプト>

次に、エコシスについて説明させていただきます。エコシスとは、長寿命化技術を追求することで得られる、エコロジーとエコノミー、そしてシステムプリントの言葉を短縮した京セラの造語です。モノクロ機器の本体は、通常30万枚のプリントで、約3年から5年の寿命であります。しかし、当社製品は、その間の部品は交換しない、ただトナーを入れるだけで、メンテナンスの必要がありません。我々は、さらに高速機でも約50万の長寿命化を実現しており、カラー機についてもすでに約20万枚、新製品では、30万枚までの長寿命化を実現いたしました。長寿命は、すなわち部品の交換が少ない、つまり環境にやさしく、ランニングコストも安く、経済的となります。このエコシスコンセプトをすべての製品に投入いたしました。当社は、業界の中で小さな規模ではありますが、そのなかで毎年業績を伸ばしてきたのは、このエコシスコンセプトが市場において理解いただいた結果であると自信をもっております。

<スライド33：エコシスが創るユーザーとディーラーへのメリット>

当社製品をご使用いただいた際の具体的なメリットをご説明いたします。プリンタでは、TCO、すなわち本体の購入費、ランニングコスト、サービスコストのトータルコストで安くなるように設計しております。複合機の場合は、製品の価格競争力を高める努力はもちろんですが、それらを販売した後でサービスを行う

ディーラー様のサービス原価を下げるよう設計しております。このような製品コンセプトが、ディーラー様に受け入れられており、当社の製品を扱っていただけるディーラー様が着実に増えております。このように京セラミタは、TCOとTCSでユーザー様とディーラー様の両方に他社では出来ない大きなメリットを提供することで、企業の発展を目指してまいります。

<スライド34：エコシスの信頼性について米国の評価機関が報告>

このような特徴を持つ当社の複合機が、米国のOPAの評価調査で、2002年、2003年に続いて2005年においても、信頼性でナンバーワンに評価されました。当社は、製品の長寿命をうたう以上、高品質を保証しており、絶対に不良を作らないよう努力しております。故障が頻繁に起こり、その都度部品を交換しているようでは、長寿命とはいえません。長寿命は、我々が最も重視していることであり、長寿命を保証することが我々の使命であると考えております。このように長寿命を実現するためには開発、設計、部品調達などにおいて大変な苦労が伴いますが、その結果、このような高い評価が得られたことは、大変うれしいことであり、当社の自信でもあります。この長寿命化は、カラー製品についても実現してまいります。

<スライド35：R&Dセンターの設立 将来の画像技術を強化>

当社は、これまで開発が分散していることで、問題もありましたが、2008年4月の完成に向けて、新しいR&Dセンターを建設中であり、10年先、さらにもっと先を見据え、要素技術を強化してまいります。また、新しい技術者の採用や、教育にも力を入れてまいります。当社は、これまでに市場で認められた独自の技術をさらに向上させることで、情報機器関連事業の拡大を図ってまいります。